



Deep Access & Ball-Wedge Bonder 53xxBDA

Bond System

Drahttypen	Golddrähte 17,5-50 µm auf 2"-Spule Aluminiumdrähte 17,5-75 µm auf 2"-Spule Bändchen von 30x12,5 µm bis 250x25 µm
Bondkopf	Ball-Wedge & Deep Access für Gold- u. Alu Drähte Standardkapillare 16mm Länge (optional 19mm) Standardwedges von ¾" Länge (optional 1") Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S Generator 67kHz (optional 100, 120, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub • Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub • Standard-Arbeitshöhe: 55 mm • Manipulator in X und Y: 18x18 mm • entspricht Untersetzung: 1:7
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, • Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In, • interne Festplatte, Bedienung und Menüführung über Shuttlerad mit Quittierungstaster
Software	<ul style="list-style-type: none"> • programmierbare Einzelbonds • Loopformen speicherbar
Steuerung	Manuell, Teil-Automatisch
Abmessung	B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
Anschlüsse	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

Der Universal Bonder 53xxBDA verarbeitet Golddrähte von 17,5 bis 50 µm und Aludrähte von 17,5 – 75µm (Deep Access & Ball-Wedge).

Unser manueller Universal-Dünn-drahtbonder 53XX BDA ist die beste Wahl für F&E, Prototypenbau und Reparatur immer dann, wenn höchste Bondqualität gefordert ist, aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht.

Der 53XX BDA bietet zwei Bondverfahren in einem Bondkopf an: Gold-Ball-Bonden und Deep-Access-Wedge-Bonden. Der Umbau ist denkbar einfach: nur die Flame-Off-Einheit ausschwenken, die Drahtklammer einsetzen und die Bondkapillare gegen einen Wedge austauschen.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben optimale Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
Mit mechanischer Klemmung
Ø80mm



Optional:



Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

